福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会 议于 2021 年 6 月 30 日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2021年6月25日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事, 本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长陈融圣先生 召集并主持;公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决 议:

一、审议《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申 请不超过人民币 1.5 亿元的授信额度,该额度用于办理贷款借新还旧业务,该笔授 信由公司名下位于中山的房地产提供抵押担保,实际金额及授信期限以银行审批为 准。

公司董事认为: 经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申 请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳 健发展,进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易,在董事会决策范围内,无需提交股东大会 审议。

本议案表决情况: 九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》

为积极响应国家"走出去"、"一带一路"战略,公司积极着手布局海外市场,特别是"一带一路"所属范围国家及地区,基于满足香港全资子公司香港达华科技股份有限公司(以下简称"香港达华")的经营需要,公司拟对香港达华增资 1,000万美元,有利于进一步增强公司海外市场影响力,对公司拓展海外业务具有重要战略意义。

本次对公司全资子公司增资事项不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本次投资的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案表决情况: 九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

备查文件:

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日